

【応募要領】

半導体産業技術交流会 受注企業の募集について

以下は、半導体産業技術交流会（以下「技術交流会」という。）へのエントリーについてのご案内となります。積極的なご提案をお待ちしております。

なお、ご提案頂いた内容は、技術交流会とその後のマッチング以外の目的で利用することはありませんので、可能な範囲で詳細にご記入下さい。

また、皆様の連絡先は、関連事業（セミナーやワークショップのご案内など）に使用させて頂く場合がございますが、それ以外でご本人の同意なく第三者に開示・提供することはありません。

1. 概要

中国地域半導体関連産業振興協議会では、以下6社の半導体製造装置メーカー等（以下、「発注企業」とする。）に対して技術を持つ企業が提案を行うことで、相互の交流・連携の「きっかけ」づくりをサポートするための商談イベント「技術交流会」を開催します。

このたび、技術を提案する企業（以下、「受注企業」とする。）の募集を行いますので、本要領をご確認いただき、参加申込み手続きを行ってください。

なお、技術交流会に参加するためには、発注企業による商談先の選考を経る必要があります。ご提案の際には、次ページの発注企業のニーズ等の情報も参考にしてください。

<発注企業>

- ・ 株式会社ジーイーエル
- ・ 株式会社ジェイ・イー・ティ
- ・ タツモ株式会社
- ・ 株式会社ディスコ
- ・ 東京エレクトロン株式会社
- ・ マイクロンメモリジャパン株式会社

【技術交流会イメージ】



発注企業のニーズ等の情報

	提案してほしい内容のカテゴリ	提案してほしい内容に関するキーワード	解決したい内容に関するニーズ
(株)ジェーイーエル	<ul style="list-style-type: none"> ◆新工法・プロセス革新・DX ◆原材料・資材等の調達 ◆業務提携 	<ul style="list-style-type: none"> ◆画像解析 ◆集積回路基板開発/設計 	(公開情報なし)
(株)ジェイ・イー・ティ	<ul style="list-style-type: none"> ◆コスト削減 ◆新工法・プロセス革新・DX ◆素材 ◆業務提携 ◆流通・在庫管理 ◆人材育成 ◆持続可能性。環境に配慮した製品やプロセスの提案。サステナビリティに関する取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ◆モータドライバへ取付可能な速度超過、位置変化を確認できる機能安全ユニット ◆高温・耐薬性部材、特に PTFE、PFA の代替材料 ◆半導体ウエハの表面温度を非接触で測定できるもの(50℃～300℃) ◆高温タンク(170℃以上)の下に設置可能なシート状の重量計 ◆170℃の液体レベルを非接触で測定可能なレベルスイッチ(センサ) ◆小型・高効率の熱交換器 ◆ステンレス材へのΦ1μm以下のピコホール加工(若しくは同等の通過径を有する焼結フィルタ) ◆クリーン化技術(工法) ◆耐久性試験など部品に対する性能評価 ◆新しい素材などの技術 	<ul style="list-style-type: none"> ◆(完全溶け込み)溶着可能な PTFE 部材、若しくは PTFE 溶着工法 ◆設計委託における外注化 ◆3D 設計、PDM 等の新規構築の注意点、実例 ◆設備製作に関する効率化(作業改善)
タツモ(株)	(公開情報なし)	(公開情報なし)	(公開情報なし)
(株)ディスコ	(公開情報なし)	(公開情報なし)	(公開情報なし)
東京エレクトロン(株)	<ul style="list-style-type: none"> ◆コスト削減 ◆新工法・プロセス革新・DX ◆廃棄物処理・リサイクル ◆原材料・資材等の調達 ◆業務提携 ◆流通・在庫管理 ◆その他(安定調達・柔軟な体制確保) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆樹脂部品のコストダウン提案 ◆樹脂部品の DX 対応、工数管理体制がある ◆樹脂部品の自動溶接ロボット導入 ◆フッ素材料の安定調達 ◆板金部品のコストダウン提案 ◆板金部品の DX 対応 ◆板金部品の溶接ロボット ◆AL 切削、φ600～φ800 の加工部品の安定調達 ◆樹脂部品、切削加工～射出成型まで一貫でのコスト・安定調達提案 	<ul style="list-style-type: none"> ◆樹脂部品の業務改善、コスト削減 ◆DXを用いてのコスト削減、省力化、リードタイム短縮(短納期対応)を図りたい。 ◆JIT 化での在庫を持たない運用なども検討したい。 ◆樹脂の射出成型を採用して、コスト低減を図りたい ◆フッ素部品の溶接対応 ◆PTFE、PFA などのフッ素部品について、溶接対応出来る企業を増やしたい。材料調達に強みがあり、大物品・公差難易度品を出来るのが理想ではある。 ◆板金部品の業務改善、コスト削減 ◆DXを用いてのコスト削減、省力化、リードタイム短縮(短納期対応)を図りたい。 ◆JIT 化での在庫を持たない運用なども検討したい。 ◆安定調達 ◆AL 切削、大型旋盤の CAPA 不足。ターニングを複数台保有しているメーカーで CAPA 増強(安定調達)を図りたい。
マイクロメジカ(株)	<ul style="list-style-type: none"> ◆コスト削減 ◆廃棄物処理・リサイクル ◆再エネ・省エネ・蓄エネ ◆その他 	<ul style="list-style-type: none"> ◆半導体工場の特性を理解したエネルギー削減などの提案 ◆半導体工場の特性を理解した廃棄物処理やリサイクルの提案 	(公開情報なし)

2. 参加申込み対象

受注企業として参加申込みが可能な企業は、以下の国が関係する半導体関連の協議会・コンソーシアム（以下、「地域コンソ」とする。）の会員企業です。

<地域コンソ>

- ・ 北海道半導体人材育成等推進協議会
- ・ 東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム
- ・ 関東半導体人材育成等連絡会議
- ・ 中部地域半導体人材育成等連絡協議会
- ・ 中国地域半導体関連産業振興協議会
- ・ 九州半導体人材育成等コンソーシアム

現時点で、上記に該当していない企業は、事前に入会等の手続きをお願いいたします。

※各地域コンソには入会要件が設定されている場合がございますので事務局にご確認ください。なお、貴社の本社、工場、事業所等がある地域に地域コンソが設立されていない場合や入会が難しい場合等は、中国地域半導体関連産業振興協議会にご入会ください。全国の企業を対象に会員を募集しています。

(参考)

<p>■ 北海道半導体人材育成等推進協議会 https://www.hkd.meti.go.jp/hokcm/semiconductor/index.htm 【問い合わせ先】 北海道経済産業局 地域経済部 製造・情報産業課 電話：011-709-2311 E-mail：bzl-hokkaido-seizojoho@meti.go.jp</p>
<p>■ 東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム https://www.tohoku.meti.go.jp/s_monozukuri/index_semicon.html 【問い合わせ先】 東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム事務局 電話：022-221-4895 E-mail：info@t-seeds.jp</p>
<p>■ 関東半導体人材育成等連絡会議 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/index.html 【問い合わせ先】 関東経済産業局 地域経済部 デジタル経済課 電話：048-600-0284 E-mail：bzl-kanto-digital@meti.go.jp</p>
<p>■ 中部地域半導体人材育成等連絡協議会 https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/semicon/index.html 【問い合わせ先】 中部経済産業局 産業部 製造産業課 電話：052-951-2724 E-mail：bzl-chb-seizo@meti.go.jp</p>
<p>■ 中国地域半導体関連産業振興協議会 https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/handoutaikanrensangyou.html 【問い合わせ先】 中国経済産業局 地域経済部 半導体関連産業室 電話：082-224-5709 E-mail：bzl-monozukuri02@meti.go.jp</p>
<p>■ 九州半導体人材育成等コンソーシアム https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/electronics.html 【問い合わせ先】 九州経済産業局 地域経済部 情報政策課 電話：092-482-5440 E-mail：bzl-jyosei-kyu@meti.go.jp</p>

3. 全体の流れ

受注企業の参加申込みから、技術交流会当日までの流れは以下のとおりです。



主体	対応	期限
受注企業 候補	① エントリーシート等の作成・提出	11月12日(火) ～ 12月3日(火)
発注企業	② 商談先の選考	提案から随時 ～ 12月18日(水)
発注企業 & 受注企業	③ 技術交流会当日	1月14日 (火)

① エントリーシート等の作成・提出【受注企業】

受注企業としての参加申込みを行う場合は、別紙エントリーシートの作成をお願いします。エントリーシートを作成する際には、発注企業のニーズ等の情報も参考にして自社の技術を提案したい発注企業の選択を行ってください（発注企業のニーズ等に対応した提案しかできない訳ではありません）。

提案内容への理解を深めるため、補足説明資料（チラシ、パンフレット等）や説明動画がある場合は添付して下さい（補足説明資料の書式は任意ですが、電子媒体に限ります）。

エントリーシート等は、発注企業が提案技術を選考する際の材料となりますので、可能な範囲で具体的な記入・作成をお願いします。

<提出資料>

- ・【 必須 】（別紙）エントリーシート（ファイル形式は Excel）

提案内容が複数ある場合は、エントリーシート内の提案内容を Sheet 毎に分けて記載ください（様式には 3Sheet 分を設けておりますが、必要に応じてコピー・追加ください）。

- ・【 任意 】補足説明資料（パンフレット、チラシ等の電子媒体（PDF 等））

説明動画（ファイル形式は「.MP4」、「.MOV」。最長 10 分）も可。

技術交流会当日は、商談時間が一社当たり 20 分程度となるため、当日の時間が短く説明しきれない可能性がある場合や、動いているものを見せたい場合等には、補足説明資料として事前に発注企業に見ていただく説明動画を作成いただいても結構です。

※エントリーシートと補足説明資料は、機密情報を含まない公開可能情報のみで作成してください。

<提出期間>

2024 年 11 月 12 日（火）～12 月 3 日（火）12：00（必着）

<提出先>

semicon@hirogin.co.jp

※1 通あたりのメール容量が 5MB を超える場合、複数のメールに分割してお送りください。

※zip ファイルの添付はご遠慮ください（ウイルス対策の関係でメールが届かない場合がございます）。

送付頂いた資料は、発注企業の他、地域コンソに提出することがあります。予めご了承ください。

② 商談先の選考【発注企業】

発注企業毎に、エントリーシート等をご確認いただき、技術交流会の場での商談を行う受注企業をご選考頂きます。

選考の結果、受注企業として参加申込みいただいたにもかかわらず、商談に至らない場合もあります。

選考結果については、申込みいただいたすべての企業にご連絡します。

なお、選考理由に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。

<選考期間>

提案があったものから随時～12月18日（水）

※事務局は、提案があったエントリーシート等を随時、提案された発注企業に共有いたします。

<選考結果通知>

2024年12月23日（月）までを予定

③ 技術交流会当日【発注企業、受注企業】

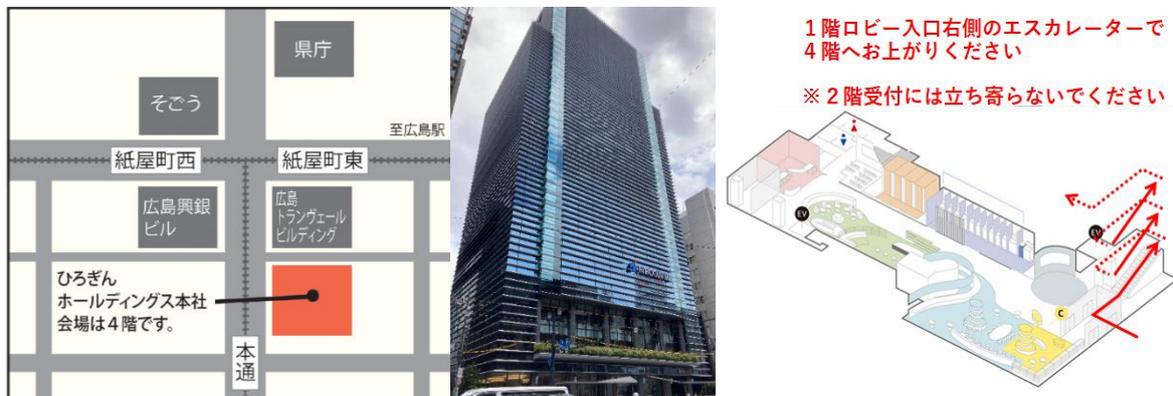
上記の選考を通過した受注企業に対して、事務局から技術交流会当日の詳細な案内（商談時間、会場等）を連絡します。

なお、技術交流会は、以下のとおり開催します。

<開催概要>

日時：2025年1月14日（火）13：00～17：00（12:30から受付開始）

場所：ひろぎんホールディングス本社ビル 4階大ホール（広島県広島市中区紙屋町1丁目3-8）



商談方法：受注企業一社あたり20分程度（質疑応答時間を含む）

※担当者全員が会場参加できない方はオンライン（Teams）での参加も可能です。

※商談時間及び質疑応答時間は、発注企業ごとに選定した企業数に応じて調整しますので、変動する可能性があります。

※商談は個室で実施します。

参加費：無料

④ 名刺交換会

技術交流会の終了後、技術交流会当日の関係者（参加企業等）を対象に以下のとおり任意の名刺交換会を実施します。

<開催概要>

日時：2025年1月14日（火）17:15～18:15頃

場所：ひろぎんホールディングス本社ビル（広島県広島市中区紙屋町1丁目3-8）4階大ホール

参加費：無料

出欠確認：選考を通過した受注企業に別途ご連絡します。

4. その他

技術交流会の成果の把握、フォローアップのため、後日商談結果のアンケートを取らせていただきますので、ご理解願います。

5. 技術交流会に関する問い合わせ先

技術交流会事務局：ひろぎんエリアデザイン(株)

(E-Mail) semicon@hirogen.co.jp

(TEL) 080-9954-7833 もしくは 080-8985-4035

※可能な限りメールでのお問い合わせをお願いいたします。

技術交流会は、技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）の「地域における先端半導体に資する人材育成推進事業」の一環で実施いたします。